



Electronics for the Future

決算説明会 2024年度 上半期業績

2024年11月8日

ローム株式会社

代表取締役社長 松本 功

- | 2024年度上半期 業績報告
- | 2024年度通期 修正発表計画
- | 設備投資の状況
- | 在庫の状況
- | 株主還元
- | パワーデバイス事業の戦略
- | LSI事業の戦略
- | 収益性改善の施策
- | デンソーとの戦略パートナーシップについて
- | 東芝との協業によるシナジーについて

2024年度 上半期 実績 (期初計画比、前年比)

(単位：億円)

	FY2024 上半期 実績	FY2024 上半期 期初計画	期初計画比	FY2023 上半期 実績	前年同期比
売上高	2,320	2,250	+3.1%	2,393	▲3.0%
営業利益	▲9	60	-	298	-
(対売上比率)	(▲0.4%)	(2.7%)	-	(12.5%)	-
経常利益	▲1	80	-	500	-
(対売上比率)	(▲0.1%)	(3.6%)	-	(20.9%)	-
純利益	20	75	▲72.4%	373	▲94.5%
(対売上比率)	(0.9%)	(3.3%)	-	(15.6%)	-
EBITDA	393	480	▲18.0%	613	▲35.8%
(対売上比率)	(17.0%)	(21.3%)	-	(25.6%)	-

期中平均レート(¥/US\$)

(152.30円)

(145.92円)

(141.31円)

期末レート(¥/US\$)

(142.73円)

(145.00円)

(149.58円)

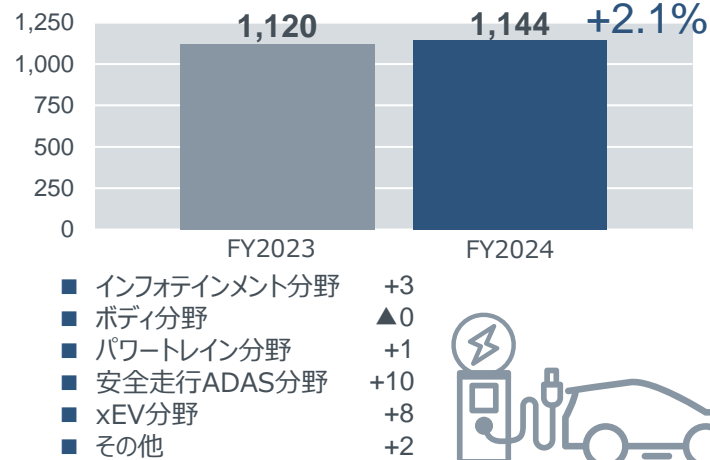
2024年度 上半期 市場別 売上の変動要因 (前年同期比)

(単位：億円)

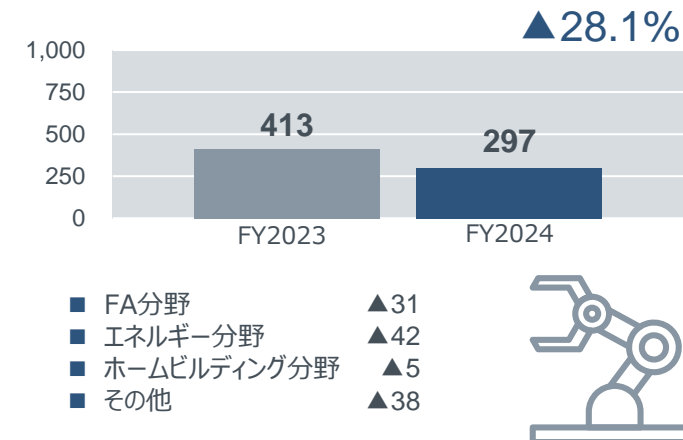
上半期売上高



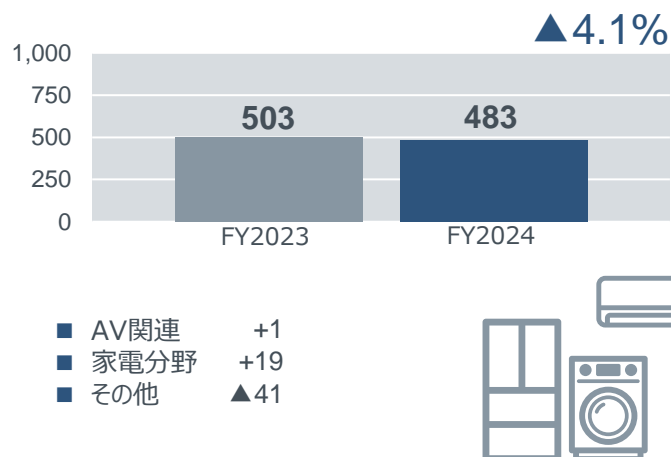
自動車



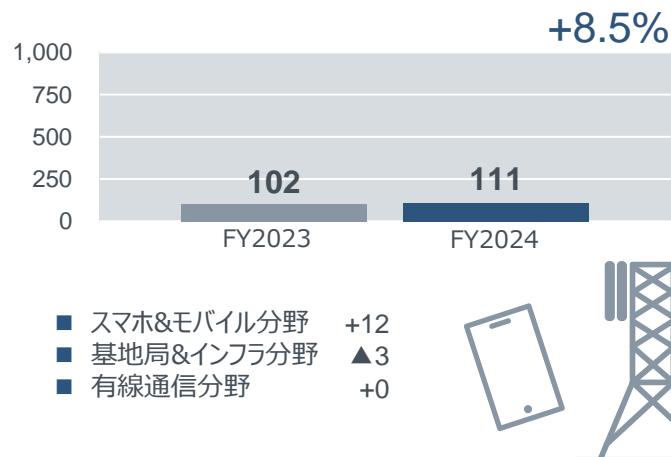
産機



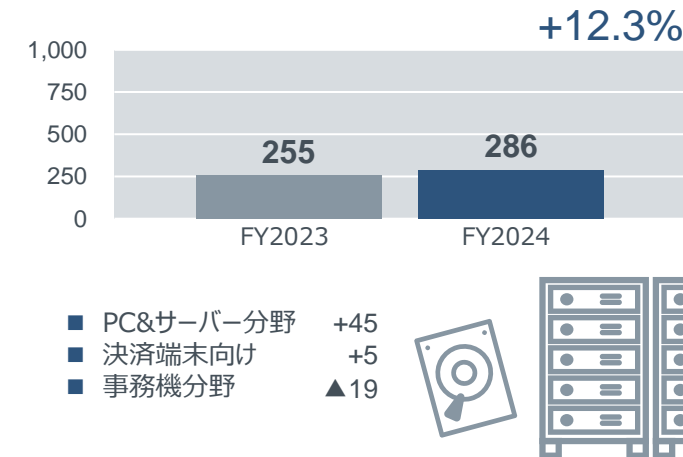
民生



通信



コンピュータ & ストレージ



2024年度 上半期 国籍別 売上の変動要因 (前年同期比)

上半期売上高

2,393億円

2,320億円

FY2023 上半期実績

FY2024 上半期実績

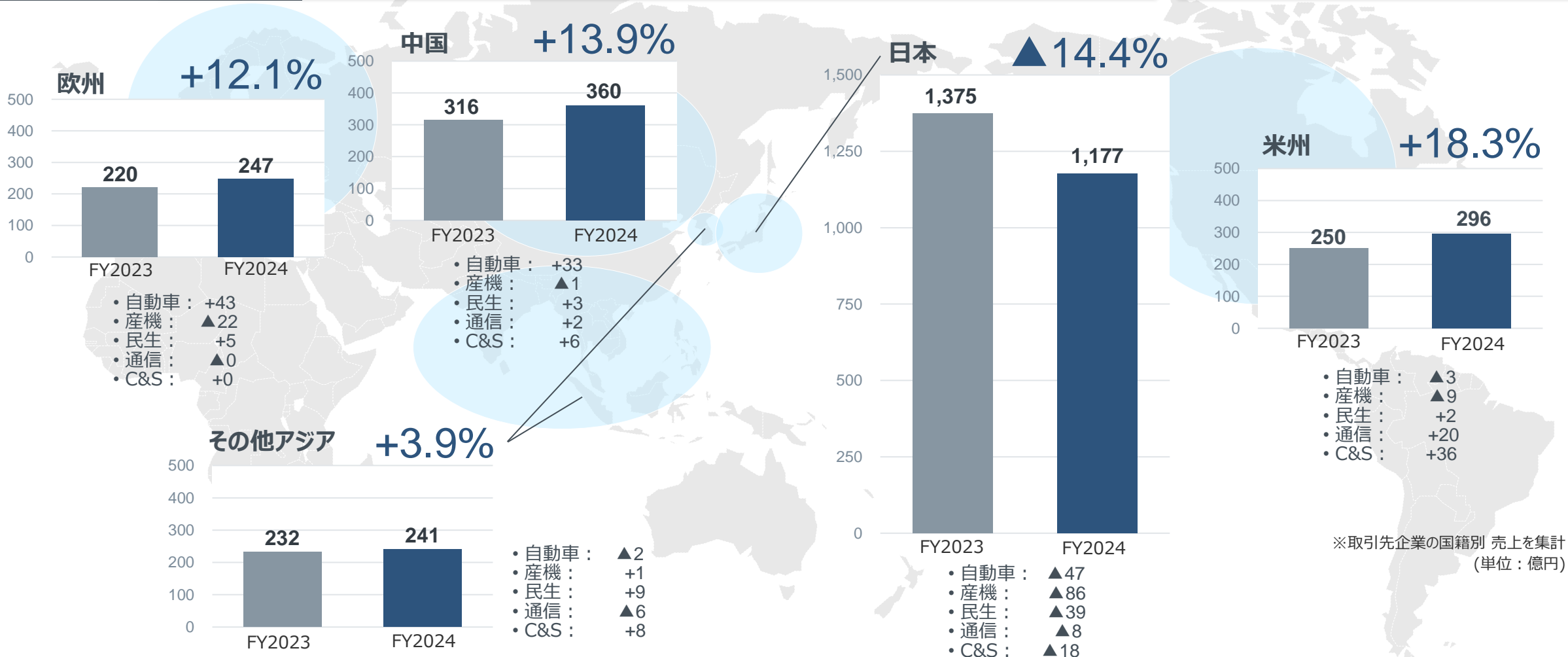
▲3.0%

海外売上高比率

42.5%
FY2023 上半期

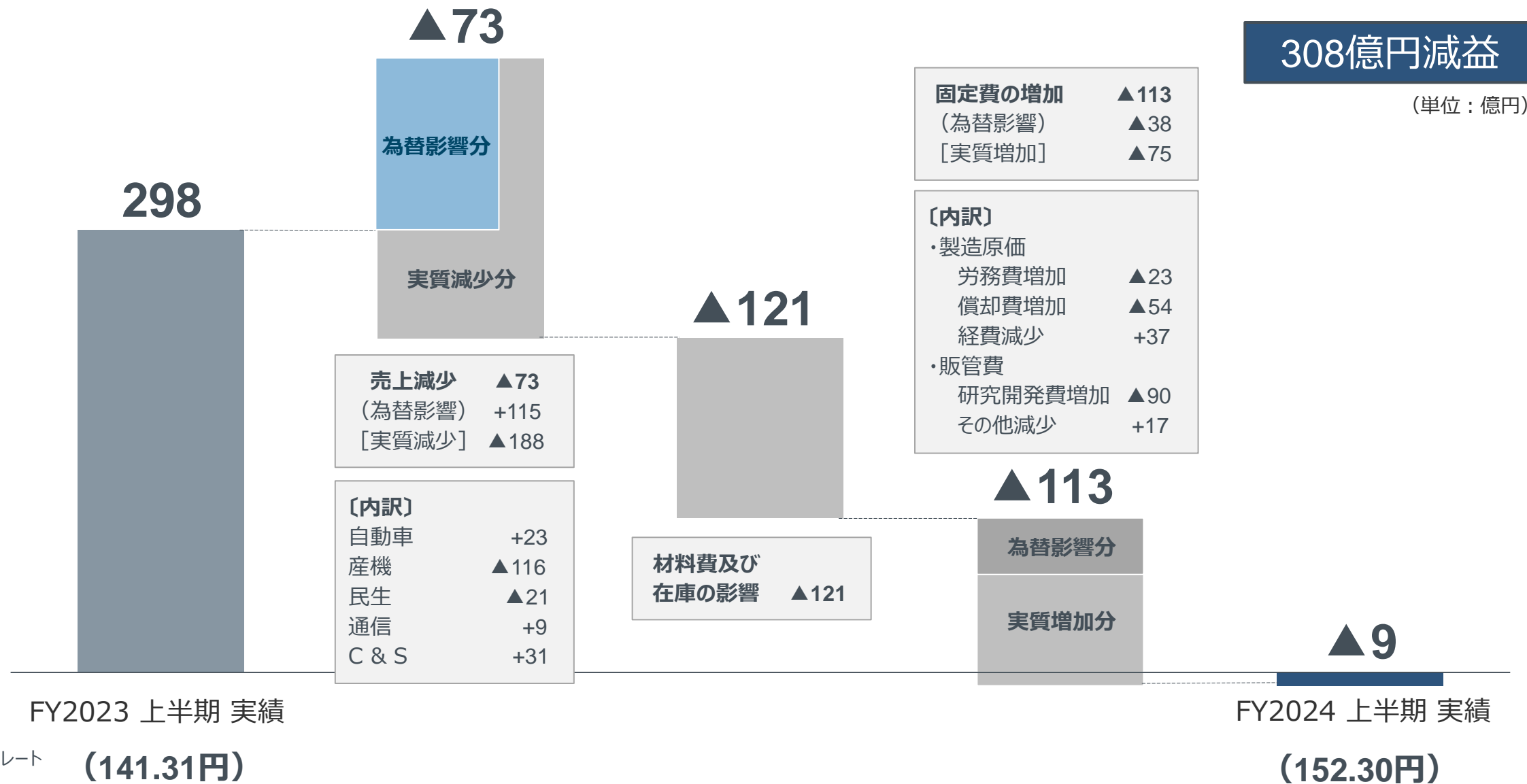
49.3%
FY2024 上半期

上半期実績 前年同期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

2024年度 上半期 営業利益 増減分析 (前年同期比)



期中平均レート
(¥/US\$)

2024年度 上半期 実績 セグメント別 (前年同期比)

(単位：億円)

		FY2024 上半期 実績	FY2023 上半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	1,042	1,073	▲31	▲2.9%
	セグメント利益	55	122	▲67	▲54.8%
	(利益率)	(5.3%)	(11.4%)	-	-
半導体素子	売上	972	1,020	▲48	▲4.7%
	セグメント利益	▲104	130	▲234	-
	(利益率)	(▲10.7%)	(12.7%)	-	-
モジュール	売上	177	169	+8	+4.8%
	セグメント利益	21	19	+2	+11.0%
	(利益率)	(12.1%)	(11.4%)	-	-
その他	売上	127	129	▲2	▲1.5%
	セグメント利益	15	12	+3	+22.7%
	(利益率)	(12.0%)	(9.6%)	-	-

2024年度 通期 業績予想 (期初計画比、前期比)

※今回 修正発表

(単位：億円)

	FY2024 修正計画	FY2024 期初計画	期初計画比	FY2023 実績	前期比
売上高	4,500	4,800	▲6.3%	4,677	▲3.8%
営業利益	▲150	140	-	433	-
(対売上比率)	(▲3.3%)	(2.9%)	-	(9.3%)	-
経常利益	▲100	180	-	692	-
(対売上比率)	(▲2.2%)	(3.8%)	-	(14.8%)	-
純利益	▲60	140	-	539	-
(対売上比率)	(▲1.3%)	(2.9%)	-	(11.5%)	-
EBITDA	742	1,067	▲30.5%	1,153	▲35.7%
(対売上比率)	(16.5%)	(22.2%)	-	(24.7%)	-

期中平均レート(¥/US\$)

(148.93円)

(145.49円)

(144.40円)

期末レート(¥/US\$)

(145.00円)

(145.00円)

(151.41円)

【YoY】
前年比



+10%~



+10%~+2%



+2%~▲2%



▲2%~▲10%



▲10%~

市場	今後の見通し	1H	2H
自動車 (▲0.5%)	<ul style="list-style-type: none"> BEV普及の後ろ倒しの影響でパワーデバイスの成長は限定的に。 日系OEMの中国向け販売不振、認証試験問題による減産影響を加味。 		
産機 (▲19.4%)	<ul style="list-style-type: none"> 在庫調整が長期化、本格的な回復は来年度以降になる見込み。 		
民生 (▲3.9%)	<ul style="list-style-type: none"> 白物家電は回復途上であるものの、その他の民生機器は依然調整局面が続く見込み。 		
通信 (▲0.9%)	<ul style="list-style-type: none"> スマホの回復が牽引しているが、下期は全体的に需要が弱い。 		
コンピュータ& ストレージ (+3.3%)	<ul style="list-style-type: none"> サーバー向け関連は好調、下期はPCの回復が想定よりも弱い。 		

2024年度 通期計画 市場別 売上の変動要因 (前期比)

(単位：億円)

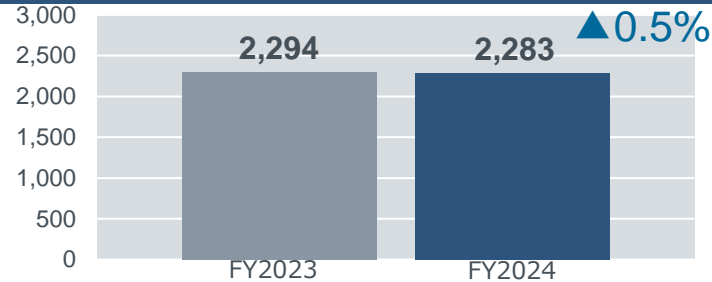
通期売上高

4,677億円 ▲3.8%
4,500億円

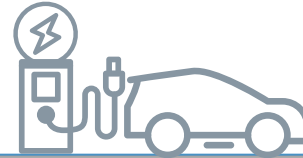
FY2023 通期
実績

FY2024 通期
修正計画

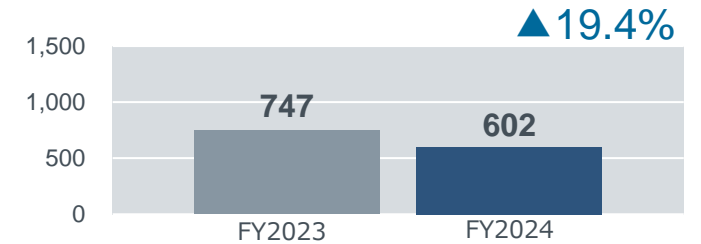
自動車



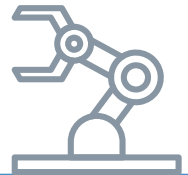
- インフォテインメント分野 ▲10
- ボディ分野 ▲12
- パワートレイン分野 +9
- 安全走行ADAS分野 +14
- xEV分野 ▲12
- その他 +0



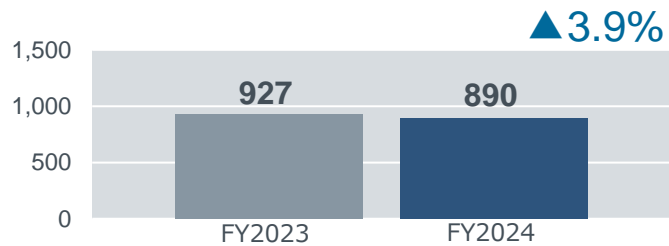
産機



- FA分野 ▲45
- エネルギー分野 ▲51
- ホームビルディング分野 ▲3
- その他 ▲46



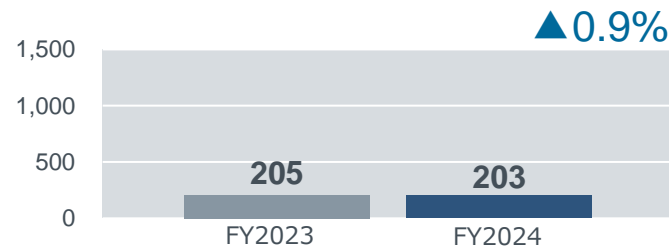
民生



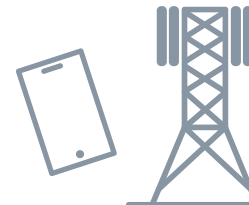
- AV関連 ▲4
- 家電分野 +1
- その他 ▲33



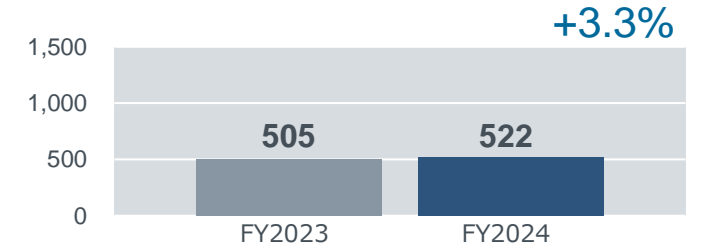
通信



- スマホ&モバイル分野 +8
- 基地局&インフラ分野 ▲8
- 有線通信分野 ▲2



コンピュータ & ストレージ



- PC&サーバー分野 +36
- 決済端末向け ▲5
- 事務機分野 ▲14



2024年度 通期計画 国籍別 売上の変動要因 (前期比)

通期売上高

4,677億円

4,500億円

FY2023 通期実績

FY2024 通期修正計画

▲3.8%

海外売上高比率

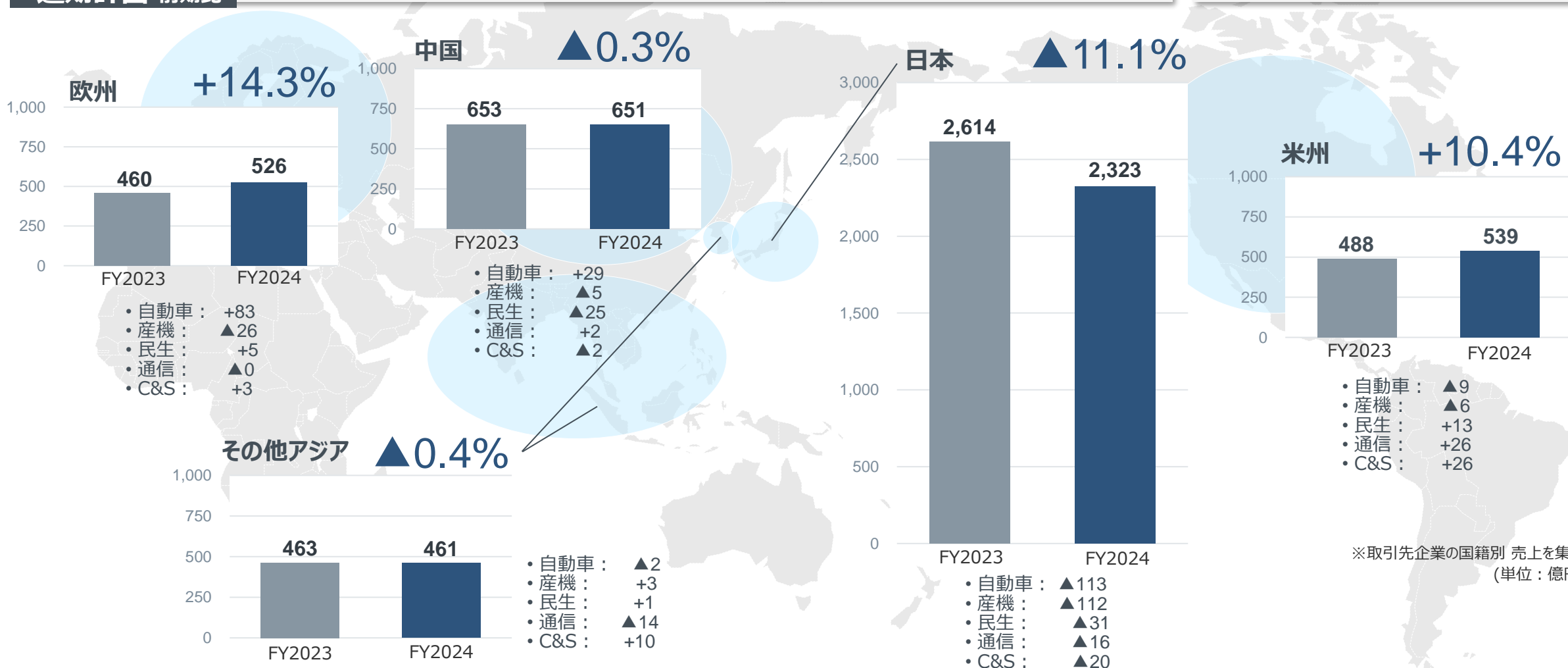
44.1%

FY2023 通期

48.4%

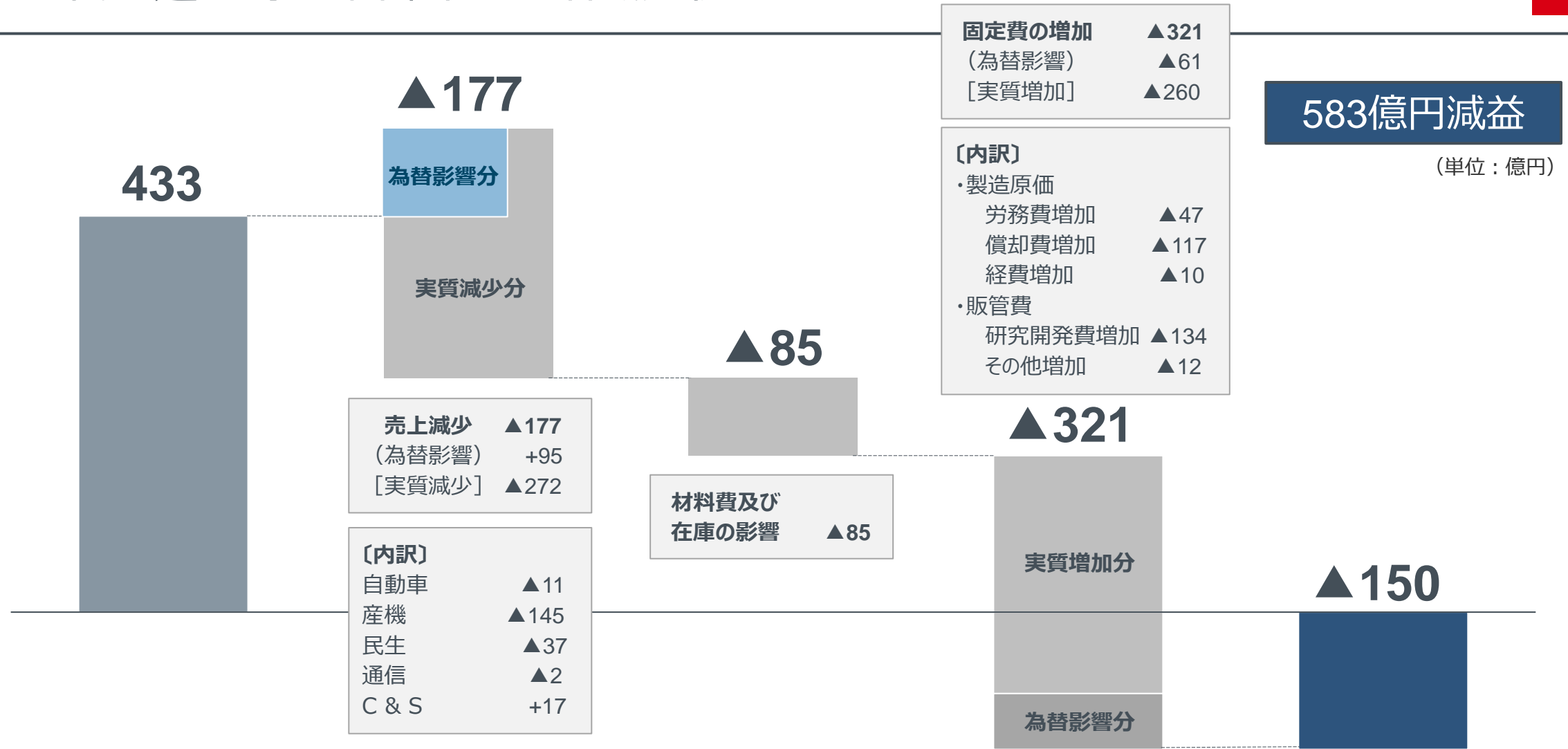
FY2024 通期

通期計画 前期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

2024年度 通期計画 営業利益 増減分析 (前期比)



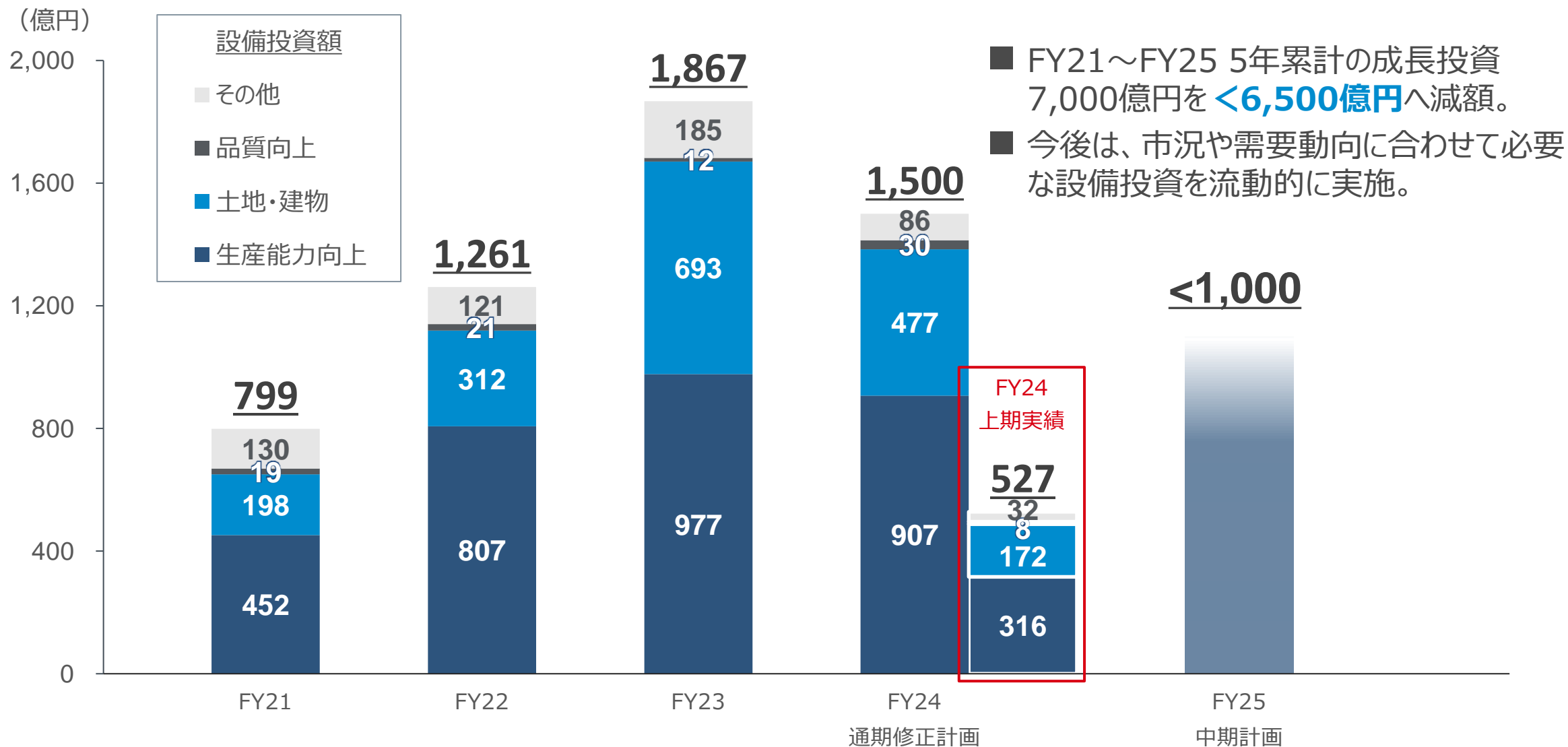
FY2023 通期 実績

FY2024 通期 修正計画

期中平均レート (¥/US\$) **(144.40円)**

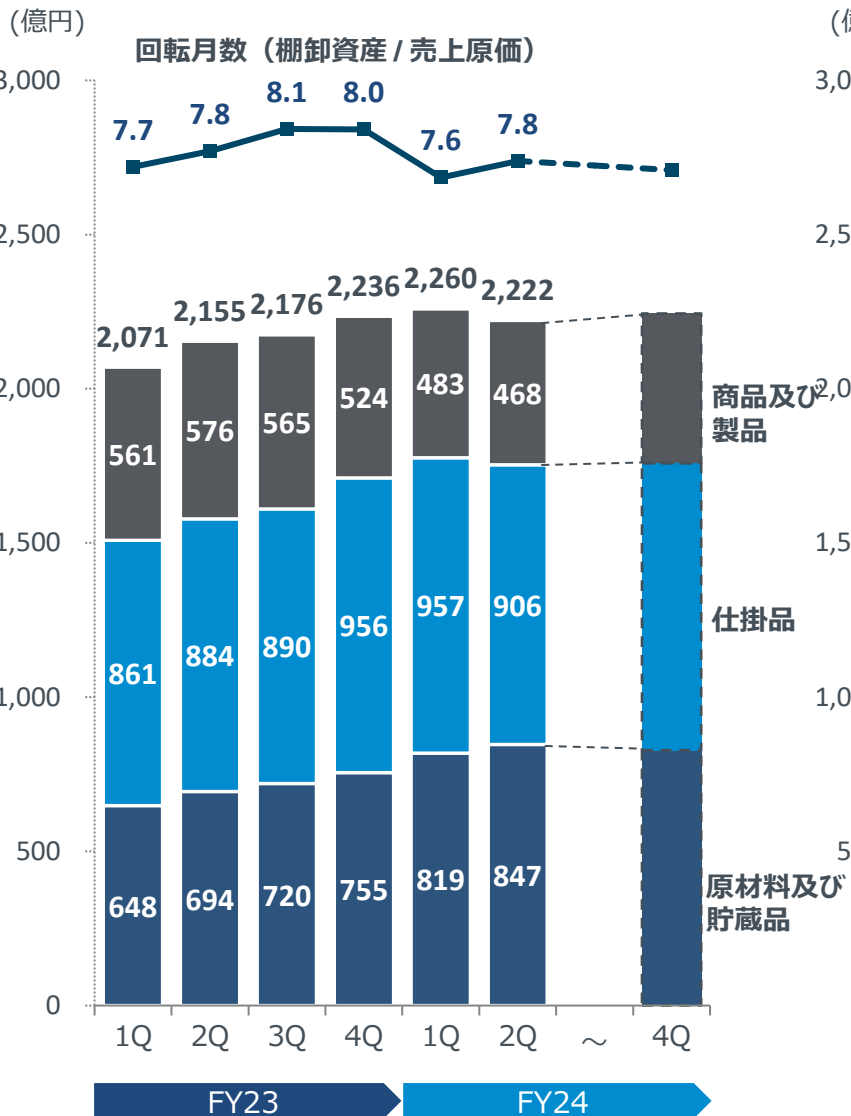
(148.93円)

設備投資の状況

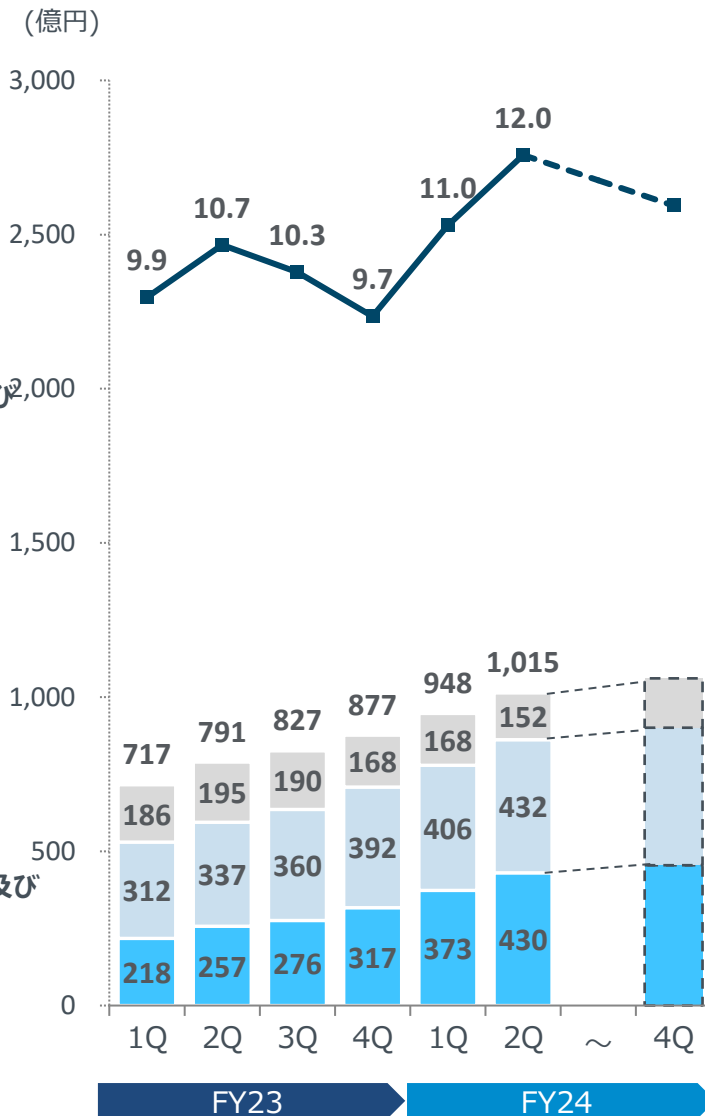


在庫の状況 (金額)

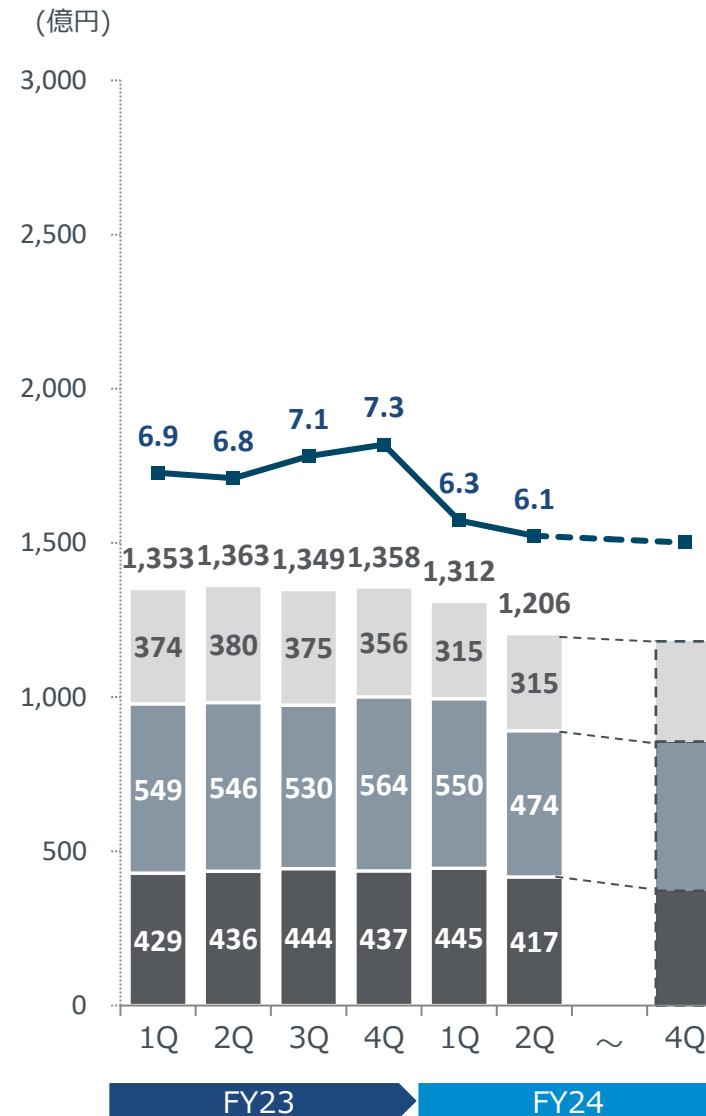
連結合計



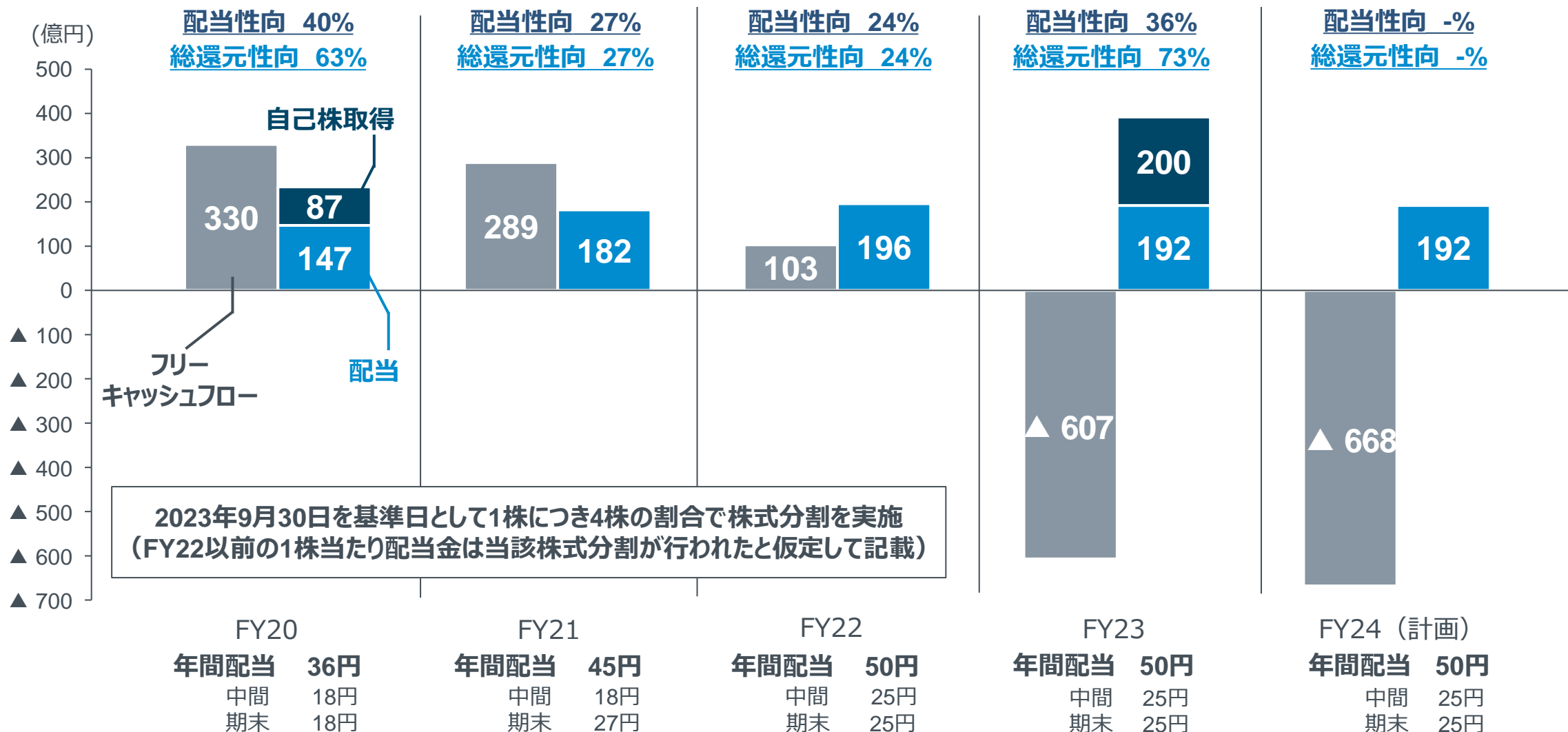
パワーデバイス



パワーデバイス以外

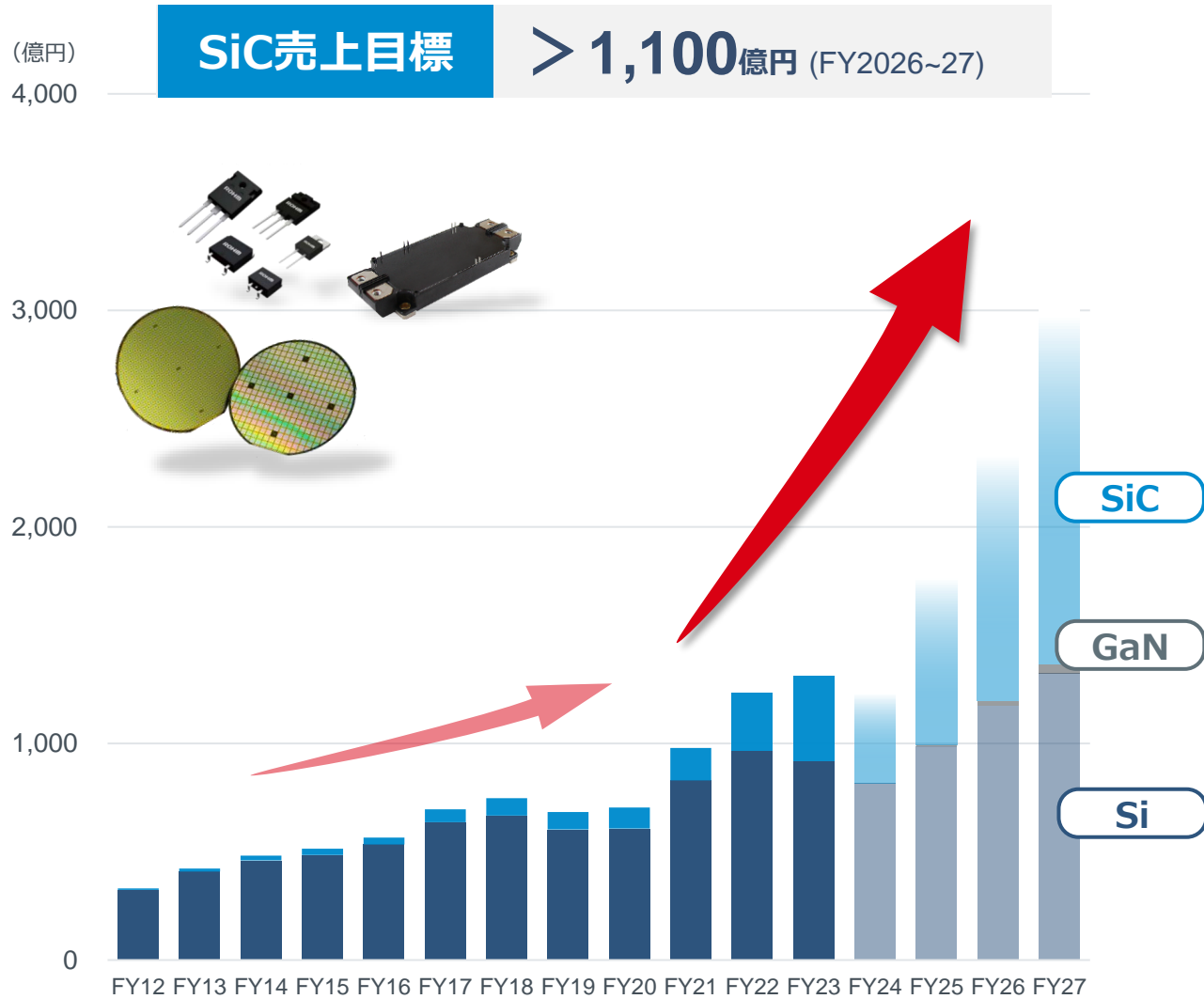


株主還元の推移

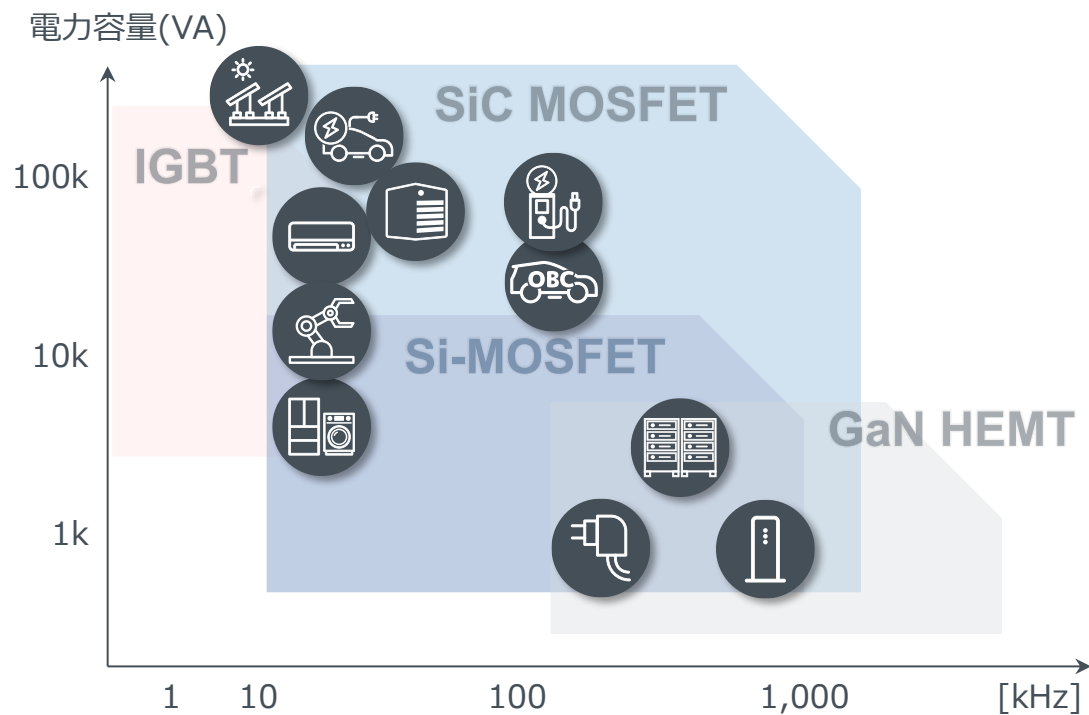


*フリーキャッシュフロー：純利益 + 減価償却費 - 設備投資

パワーデバイス事業の売上目標



パワーデバイスのアプリケーション適用範囲



SiC

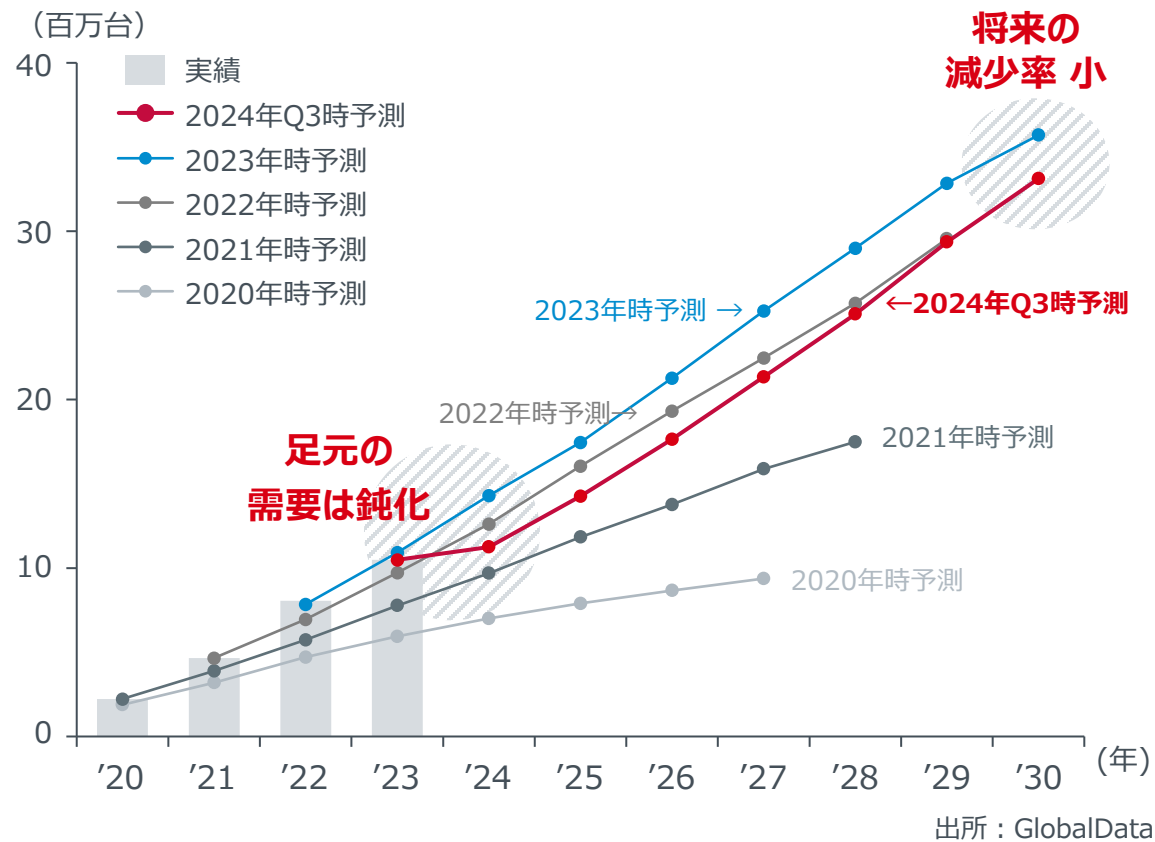
- 大電力
- 高電圧(> 600V)
- 高周波(20~200kHz)

GaN

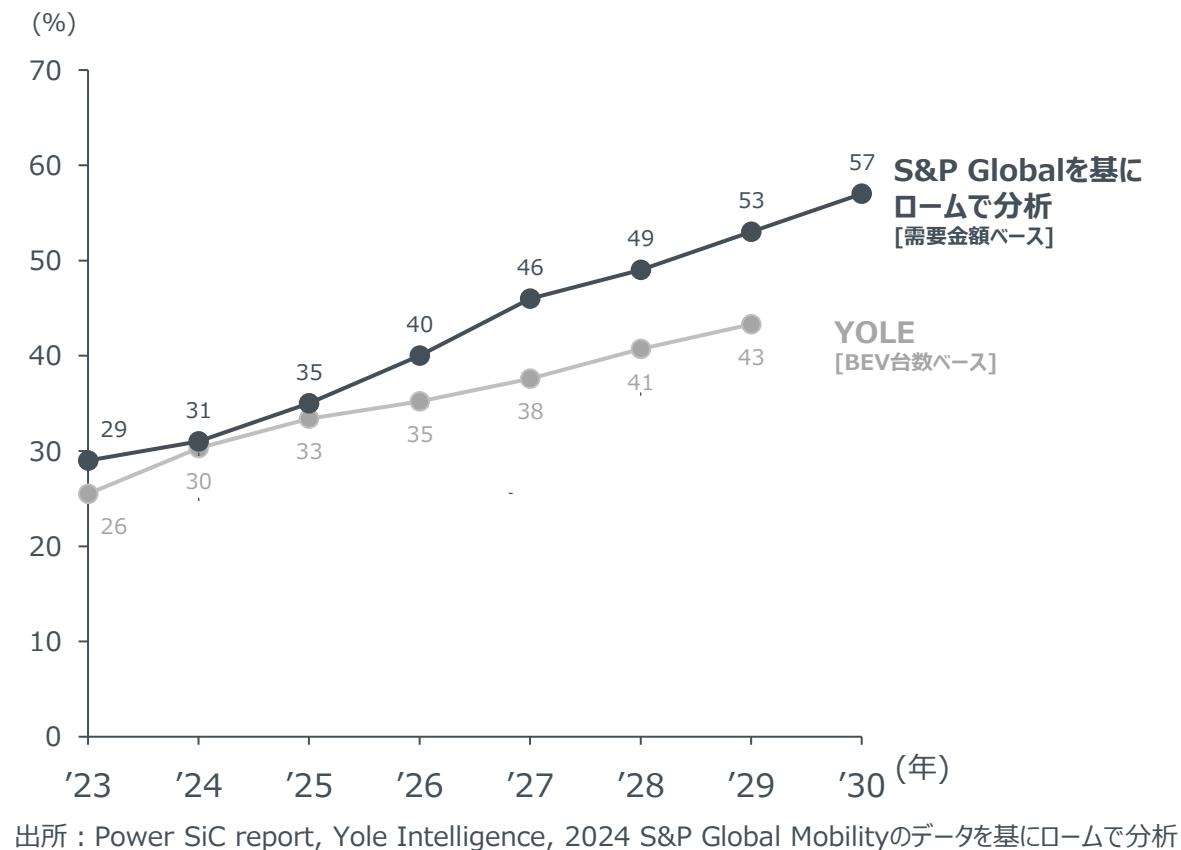
- 中電力
- 中電圧(100~600V)
- 高周波(200kHz以上)

**BEVの需要は足元鈍化しているが、将来のBEV予測台数の変化率は小さい
BEVインバータのSiC化率の伸長も引き続き中長期的に期待**

BEV台数 見立て比較



BEVインバータでのSiC化率 見立て比較



ワールドワイドで、すでに140社以上でデザインウインが確定

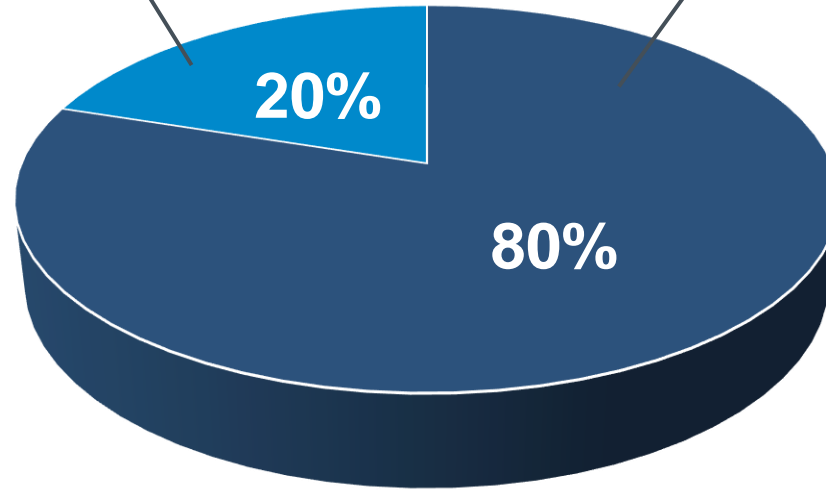
90社以上

産機その他

自動車

50社以上

2027年
市場別デザインウイン
金額構成比



OEMs



LUCID



XPENG

Tier1・2s

Astemo



KOSTAL

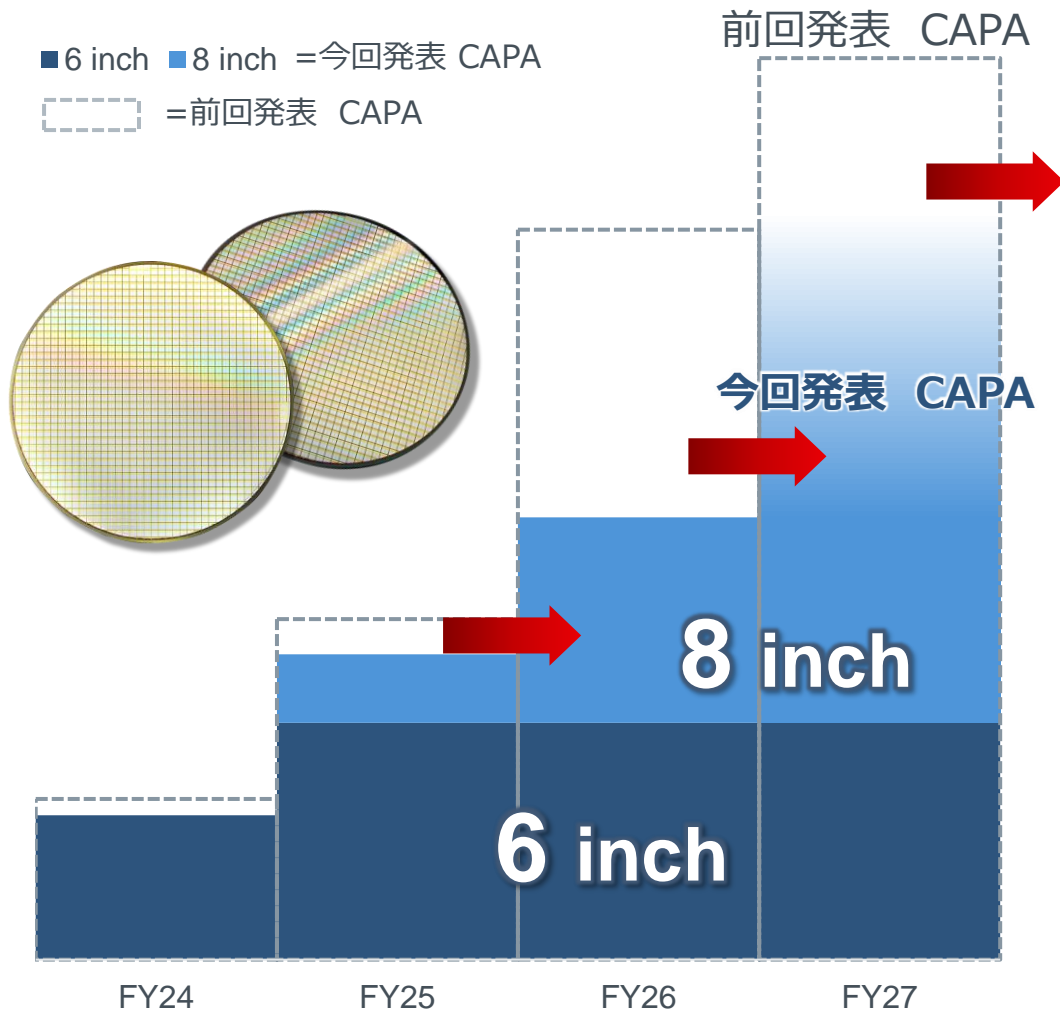


SCHAEFFLER



UAES

8インチ化の進捗は順調であり、直近の市況に合わせて投資時期を調整
宮崎第二工場の稼働準備は完了。今後の需要に応じて製造装置を導入



筑後工場



8インチラインにて
2025年 デバイス生産開始

宮崎第二工場



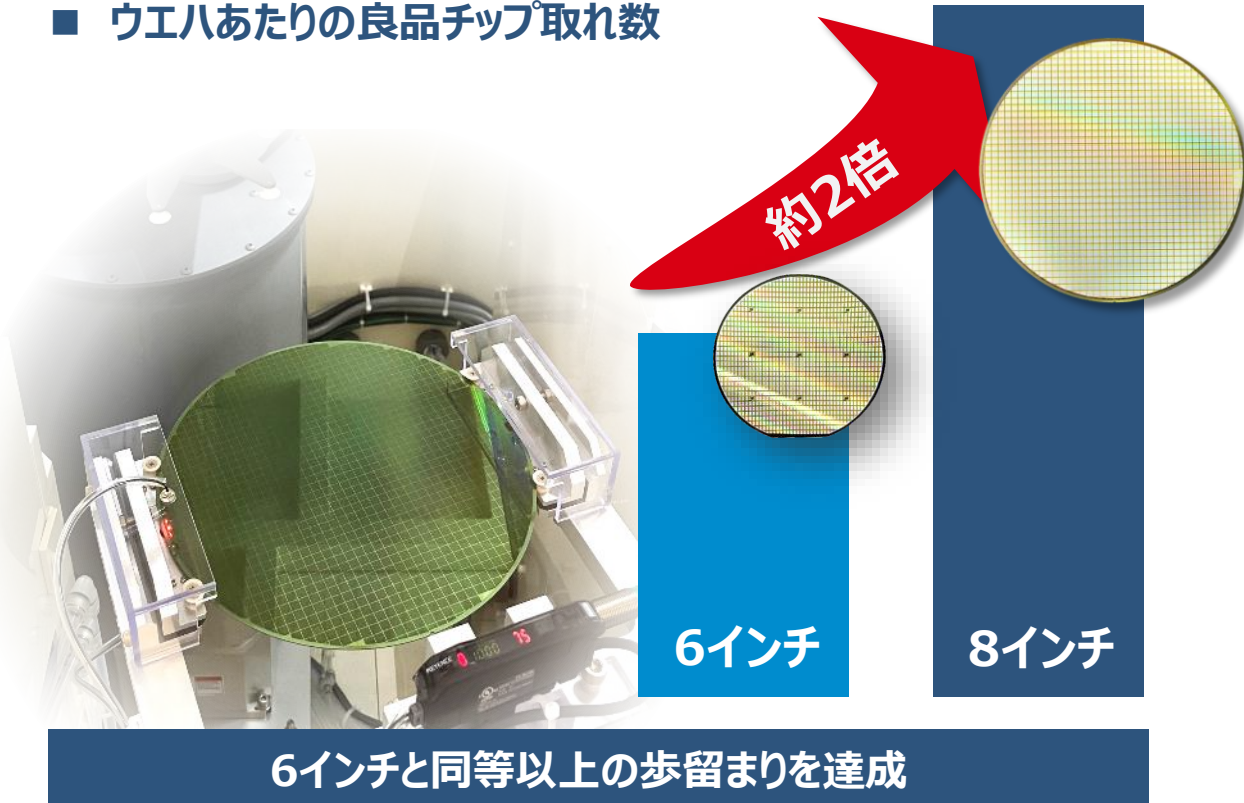
2024年 8インチ基板の生産準備完了
2025年 基板の生産開始
2026年 デバイスの生産開始

大口徑化による生産性とデバイスの先進性で業界をリード

SiC MOSFET 8インチラインの開発進捗

- 2025年より筑後工場でのデバイスの生産開始
- 面積比以上のチップ取れ数（生産効率約2倍）

■ ウエハあたりの良品チップ取れ数

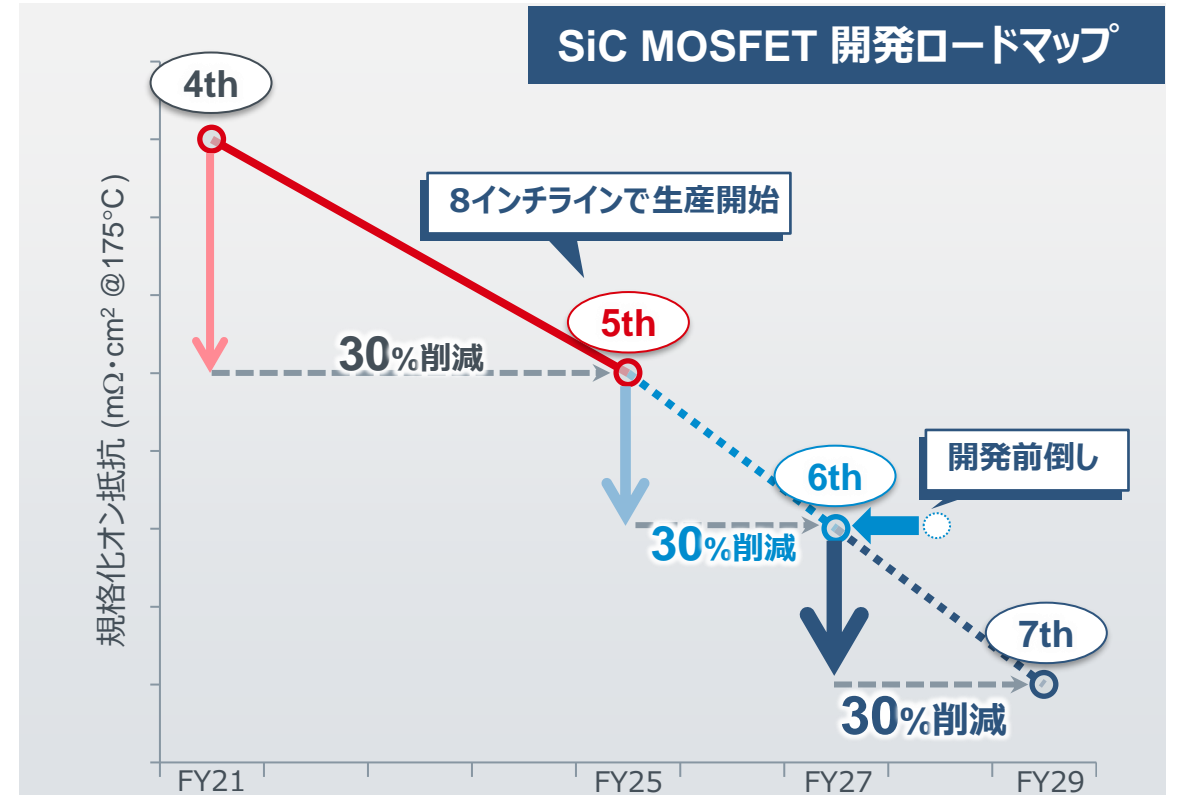


第5世代以降のSiC MOSFET開発トレンド

- 第6世代以降の開発を前倒し
- 各世代でオン抵抗を30%低減

顧客にとってのメリット

性能アップ 同じチップ面積で、定格電流16%*アップ
コストダウン 同じ定格電流のとき、チップ面積を19%*削減
*ベストケース モジュール性能による

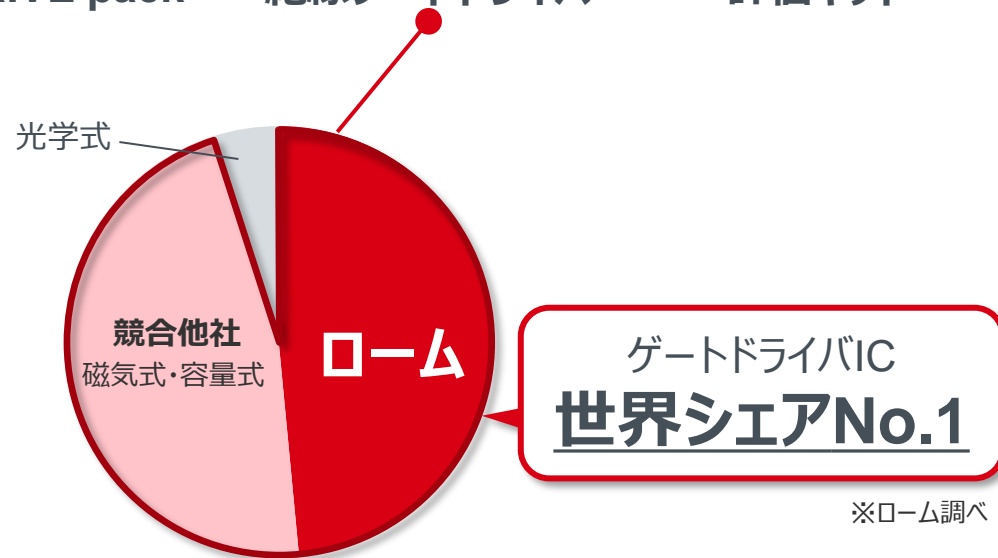
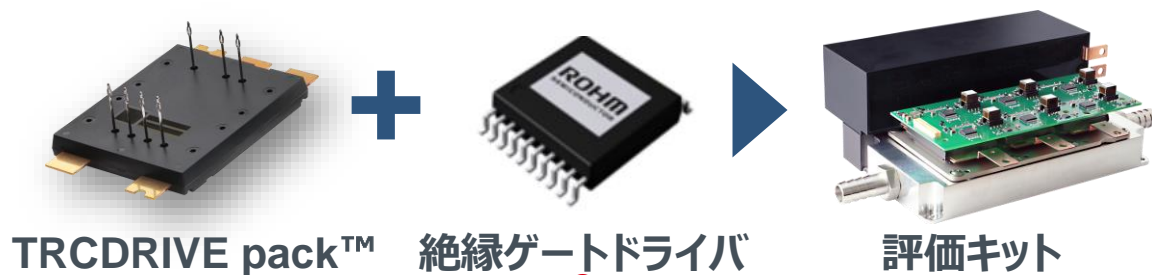


トラクションインバータでのビジネス拡大

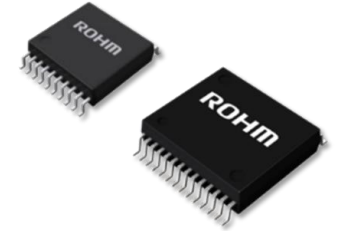
- SiC基板からパワーモジュールまでフレキシブルなビジネスモデル
- POWER BOXまで手掛けることでより高い付加価値を提供

GDICとのソリューション提案

世界No.1シェアの絶縁ゲートドライバとSiCパワーモジュールとのソリューション提案

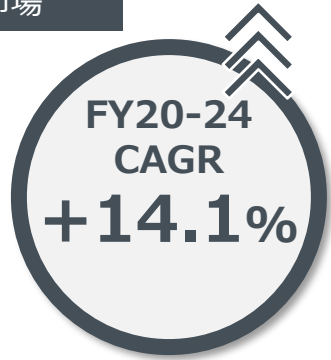


戦略TOP10分野は市場成長以上に伸長、LSI事業を牽引 それ以外の分野が伸び悩んだ

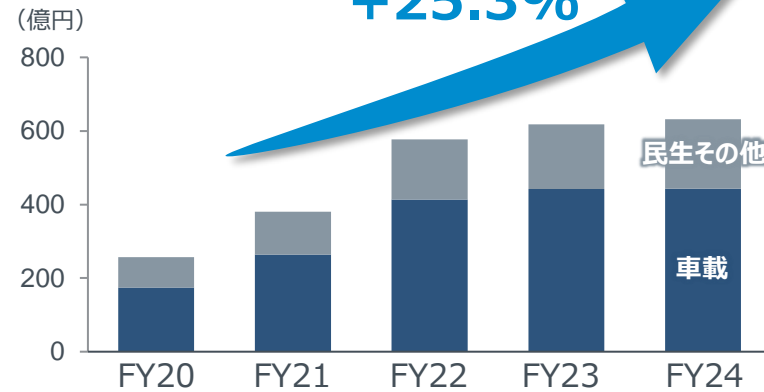


戦略トップ10分野

市場



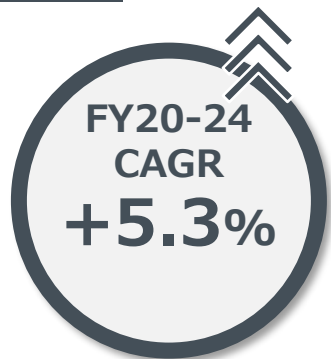
ローム売上



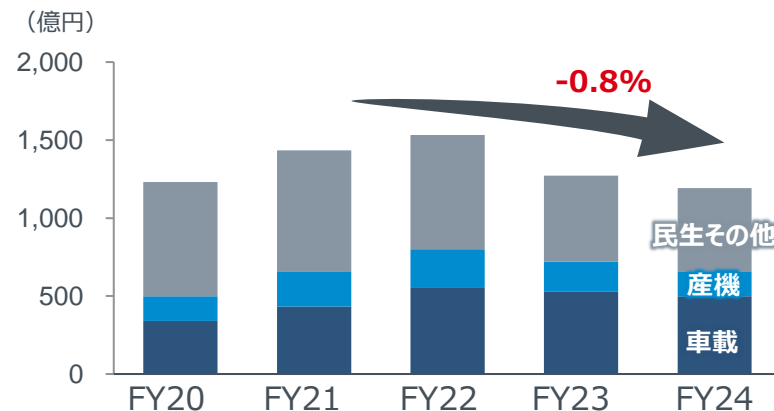
- 絶縁ゲートドライバをはじめ、高付加価値ASSP製品の投入により、市場の成長を上回る売上伸長を果たす。
- 戦略トップ10分野のうち、大半が車載向け製品となっており、対象市場に偏りあり。

その他分野

市場



ローム売上



- 注力市場である産機市場において、高成長が期待できる分野へ参入できていない。
- 民生市場における売上減少分を、その他の市場でカバーできていない。

製品単品提案型からシステムソリューション提案型への転換途上

過去のローム

- 製品単品提案
- カスタム主体
- 民生比率高

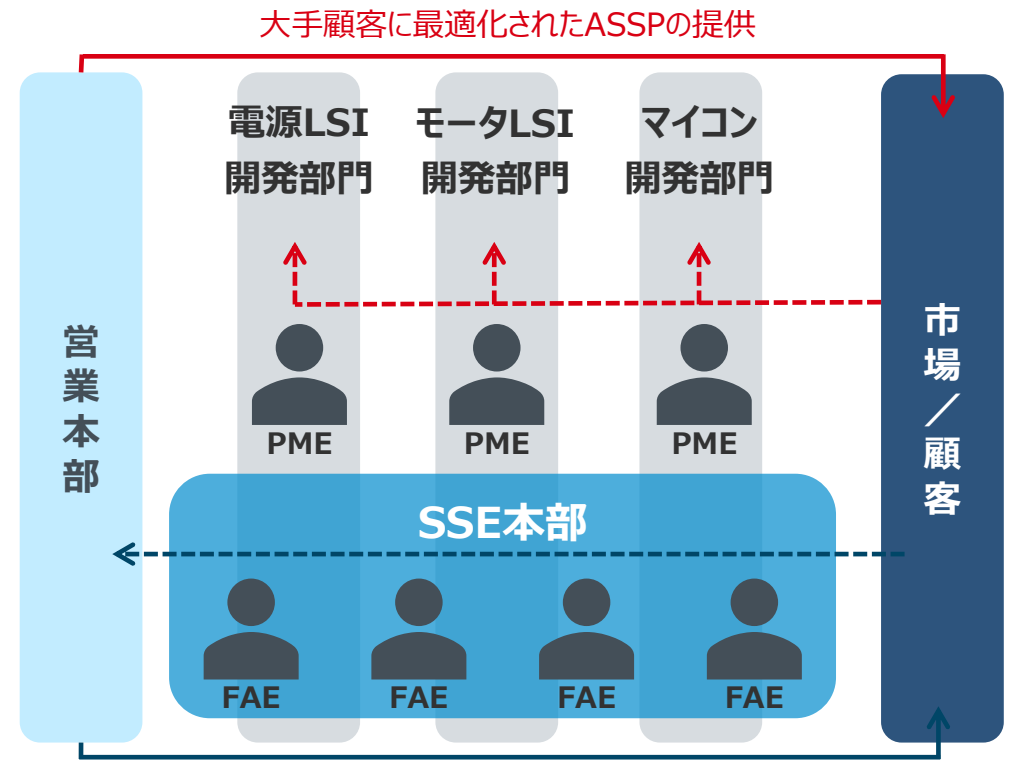
現在のローム

- 製品競争力向上 (PME)
- ASSP・汎用
- 車載注力

現状の課題

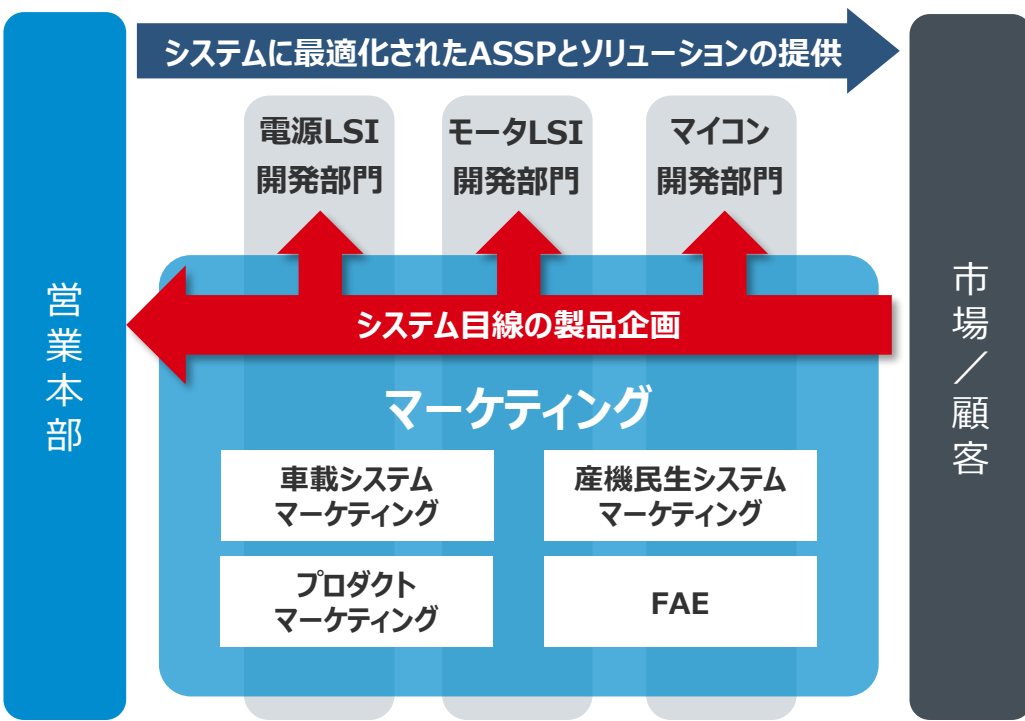
- FAEによる、既存品におけるソリューション提案は一定の成果があったものの、新規開発を視野に入れた提案ができていない。
- PMEが開発部門に属しており、製品単品での開発提案が主となっている。
- 大手顧客向けの開発に偏重しており、ソリューション提案ではなく製品単体の性能とコストが重視される。

これらの課題を解決し、
更なるシステムソリューション提案力の強化へと繋げる！

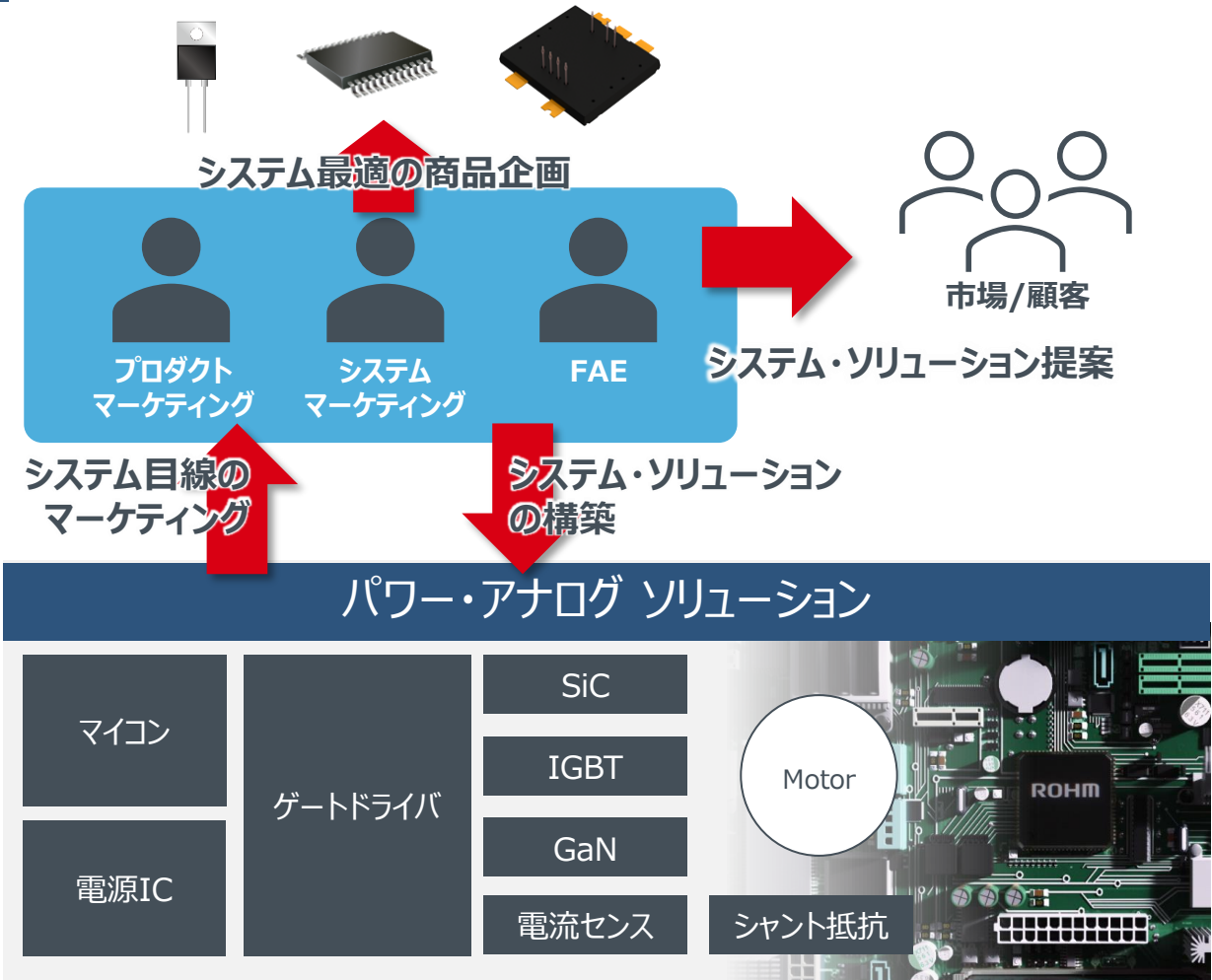


システムに軸足を置いたマーケティングの強化

- システム・ソリューション提案
- システム最適のASSP・汎用
- 車載に加え、産機にも注力



システム提案型のマーケティング



*FAE : Field Application Engineer

各市場の主要アプリケーションへソリューションで提案する営業体制

現在のローム

- 地域軸・顧客軸の営業体制
- 製品軸での単品提案
- 車載偏重の売上構成

日本市場／顧客

国内営業本部



海外市場／顧客

海外営業本部



今後のローム

- 市場、アプリケーション軸のニーズ集約
- アプリケーション軸でのソリューション提案
- 市場ポートフォリオの見直し



安定的に利益を出せる事業基盤構築のために、抜本的構造改革を断行する

売上成長以外での収益性改善策

足元は投資削減による償却費抑制と価格適正化。向こう3年で200～300億円の年間固定費を圧縮



生産拠点再編



拠点集約などによるスケールメリット・生産性向上



IDMからの一部脱却



LSIファンダリ生産比率 1→15%(2030年)
OSAT生産比率 7→30%(2030年)

24年9月アナログLSIも委託開始



設備投資の圧縮



先行投資フェーズから需要見合いの投資戦略へ
投資効率改善



人員数適正化



業務効率改善・短期的には増員をコントロール



価格適正化



不採算商品の価格見直し・新商品への置換

長年にわたって協力関係にあり、近年は絶縁ゲートドライバの共同開発にも取り組む。
さらなる連携強化に向けて、戦略的パートナーシップの検討開始に合意 [9月30日公表]

DENSO
Crafting the Core

- 車載を中心としたアプリケーション開発における製品競争力（企画、技術開発、知見）
- 豊富な品揃えによるシステム構築力

戦略パートナー
として連携強化



株式取得 >>



- アナログデバイス、パワーデバイスを中心とした技術開発力と量産実績
- 車載や産業機器向けの豊富な製品ラインアップと供給能力

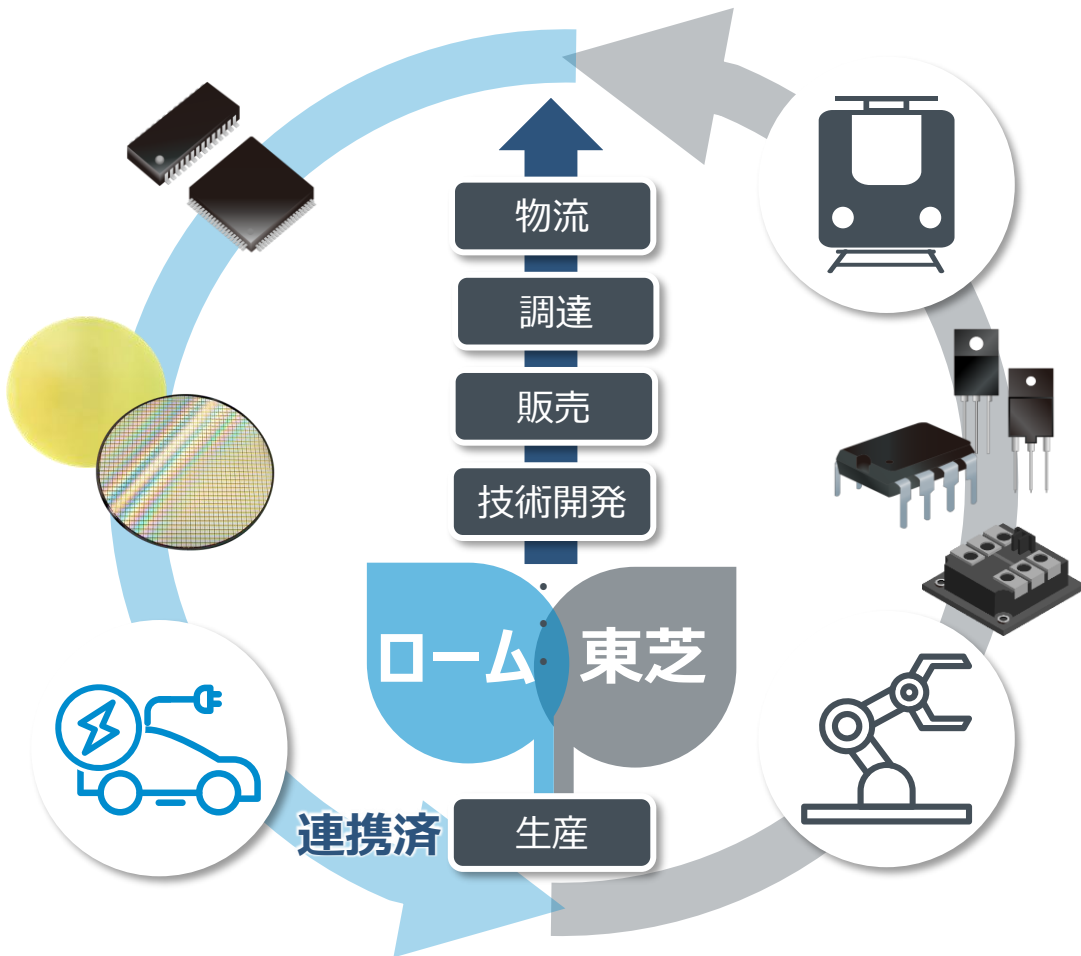
半導体分野におけるパートナーシップを検討中

高品質・高効率な
半導体の開発

信頼性の高い製品の
安定供給

東芝の半導体事業は、ロームとの親和性が高く、様々なシナジーを創出できる可能性があり、業務提携強化に向けた協議開始の提案を実施 [3月29日公表]

ローム及び東芝双方の企業価値向上を目指す



提案の概要

東芝D&S半導体事業部を中心とした半導体事業に関して、技術開発、生産、販売、調達、物流など、あらゆる事業活動で連携を強化し、両社の企業価値向上を目指すもの。

パワー半導体におけるプレゼンスの向上

技術力の強化

供給力の拡大

7月に東芝、及び日本産業パートナーズと業務提携強化に向けた協議を開始、現在、継続協議中。

<ご注意事項>

1. 当資料は投資分析を目的として作成しておりますので、投資分析にのみご使用ください。
2. 2024年度通期の予想は、現時点で得られた情報にもとづいております。従って、業況の変化などにより記載の予想と大きく異なる場合があります。

<お問い合わせ先>

ローム株式会社 IR室
〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21
E-mail : ir@rohm.co.jp



Electronics for the Future